

# 2021年度上期決算説明資料

JASDAQ 証券コード：6614

2021年12月

今を見つめなおし  
人と社会を一步先へ

1. 事業概要
2. 2021年度上期決算の概要
3. 2021年度通期業績予想の概要
4. 今後の成長戦略

1. **事業概要**
2. 2021年度上期決算の概要
3. 2021年度通期業績予想の概要
4. 今後の成長戦略

商号 **株式会社シキノハイテック**  
Shikino High-Tech Co., Ltd.

本店所在地 富山県魚津市吉島829番地

代表者 代表取締役社長 浜田 満広

設立年月 1975年1月

資本金 414,179,800円（10月31日現在）

発行済株式数 4,368,000株（株主総数5,146名）

決算期 3月末

事業内容 電子システム事業・・・半導体検査・装置関連  
マイクロエレクトロニクス事業・・・LSI設計（アナログ・デジタル）、IP開発  
製品開発事業・・・画像関連機器、CMOSカメラモジュール

従業員数 355名（2021年4月1日時点）

国内拠点 魚津工場、東京デザインセンター、大阪デザインセンター、福岡デザインセンター  
九州事業所

**社是**  
和して拓く

**社訓**  
社業を通じ社会に奉仕  
企業の永續と繁栄  
社員の幸福と人格の向上

**経営理念**  
我が社は、お客様の信頼を得る製品とサービスを作り出し、立ち止まらず、高いモラルを有し、発展し続ける企業を目指します。



九州事業所



本社、魚津工場



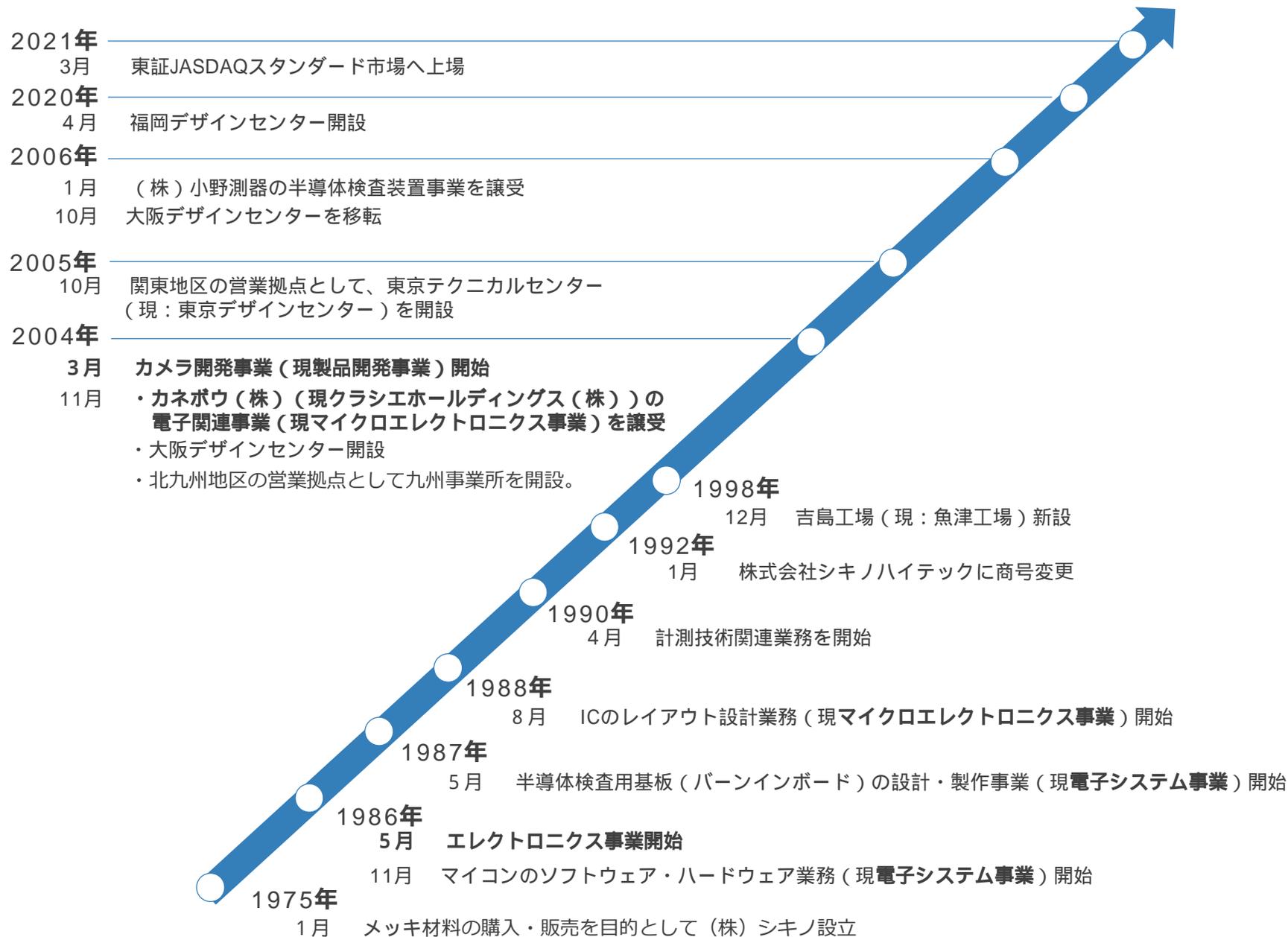
福岡デザインセンター

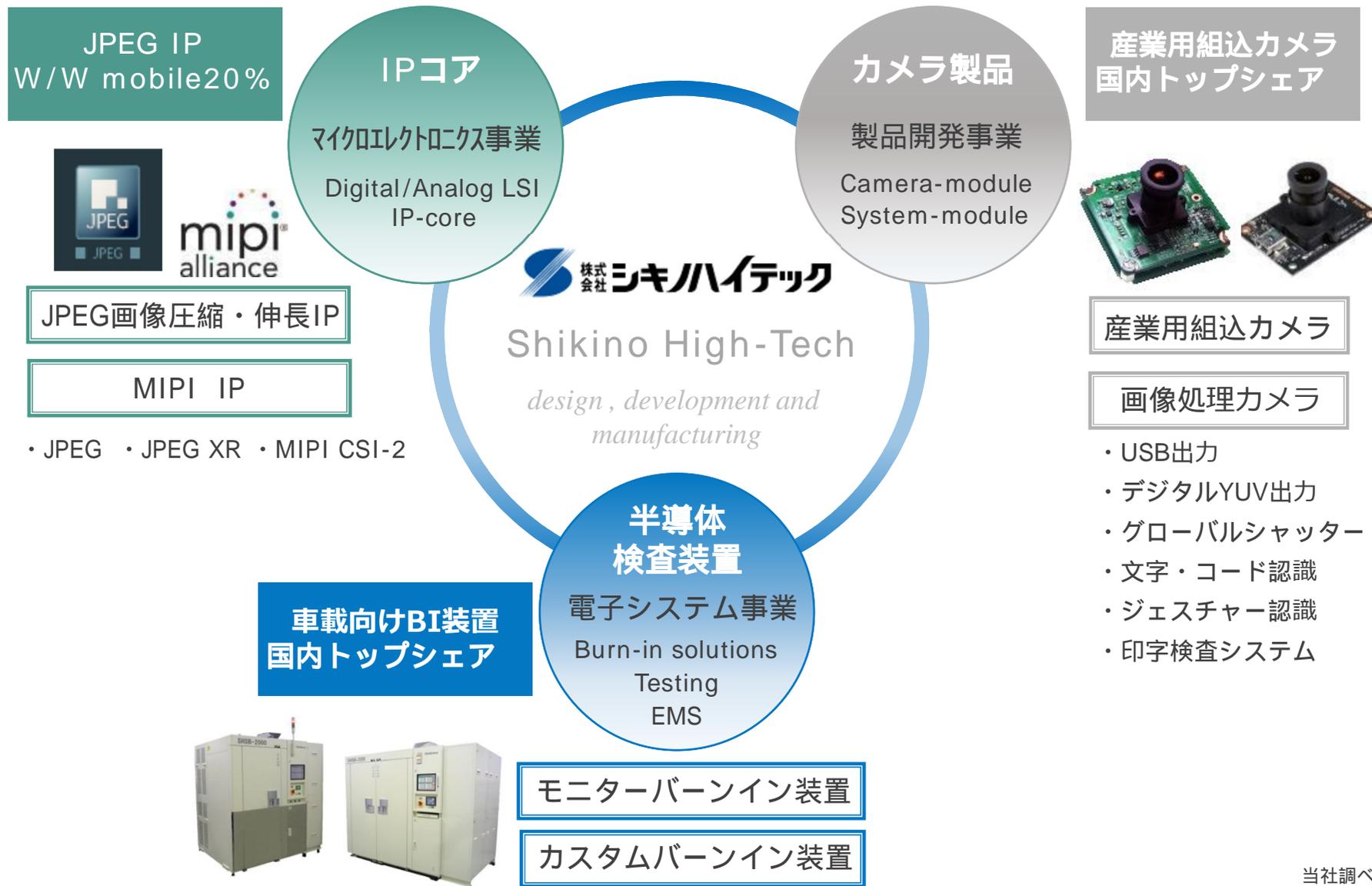


大阪デザインセンター

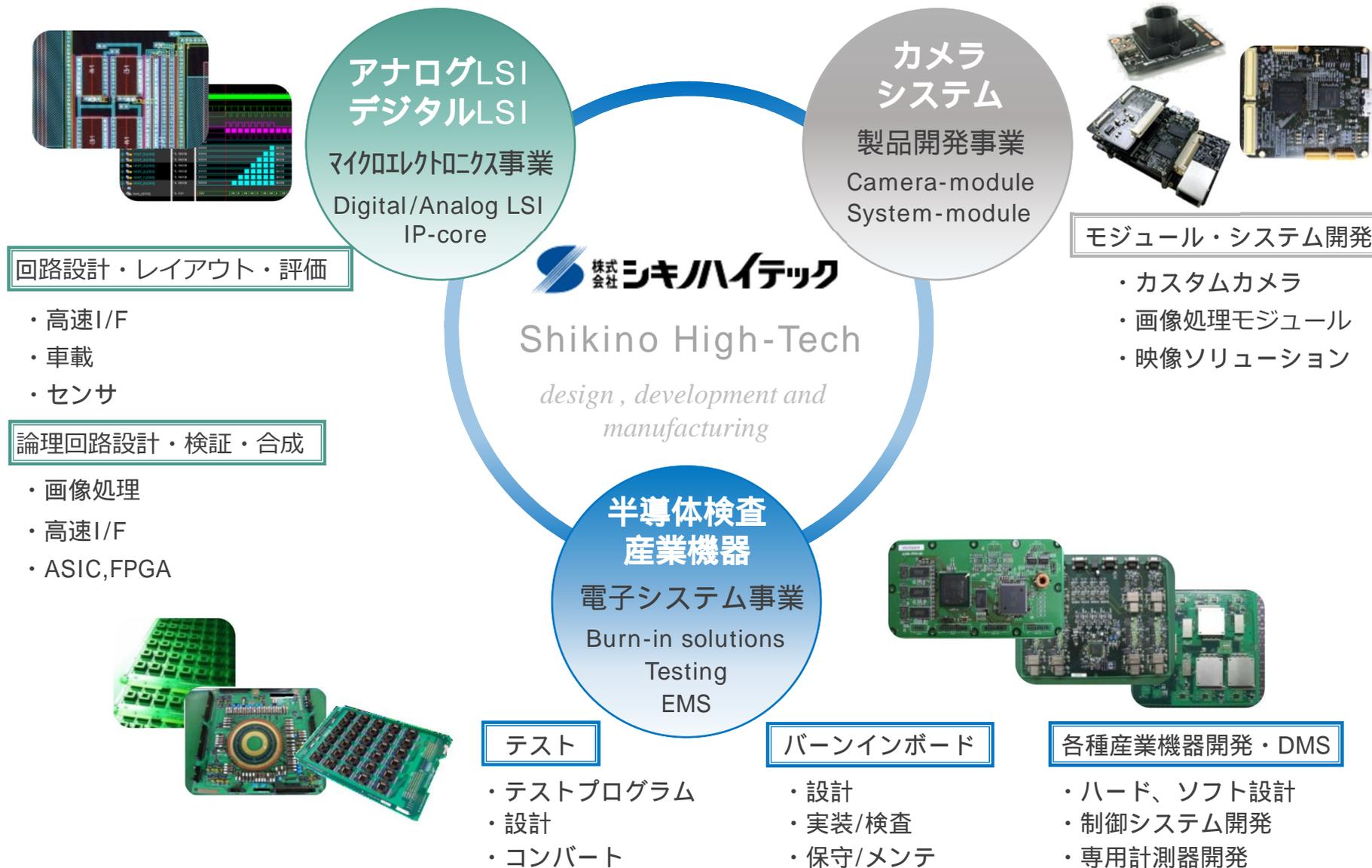
東京デザインセンター

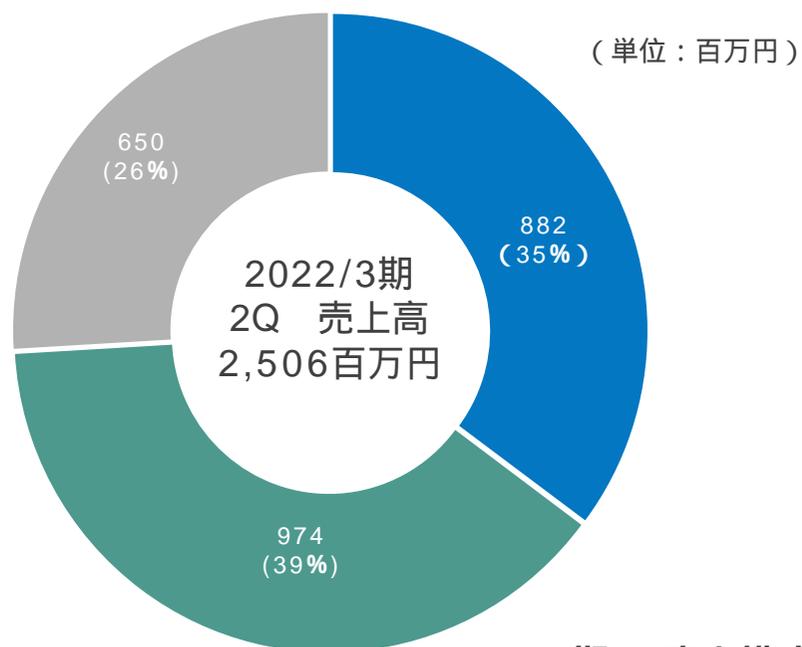




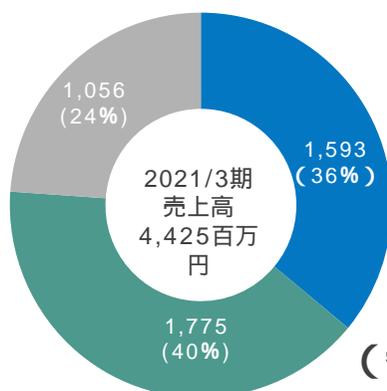


当社調べ





22/3期2Q売上構成



(参考) 21/3期売上構成

## 電子システム事業

### 半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

## マイクロエレクトロニクス事業

### LSI設計(アナログ・デジタル)、IP開発

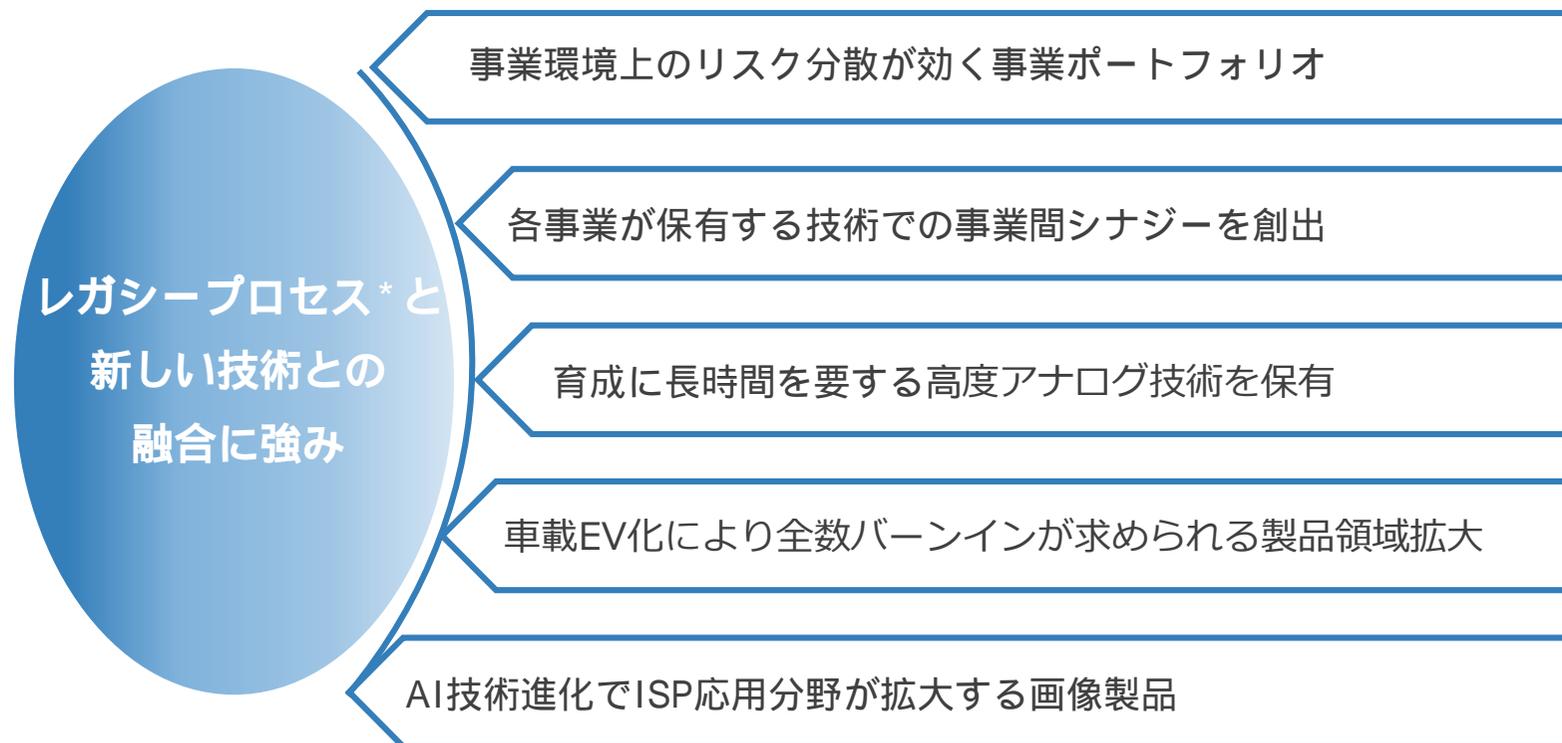
電源IC設計、高速I/F回路設計、イメージセンサ回路設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計  
JPEG、MIPI、IPコア

## 製品開発事業

### 画像関連機器開発

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール

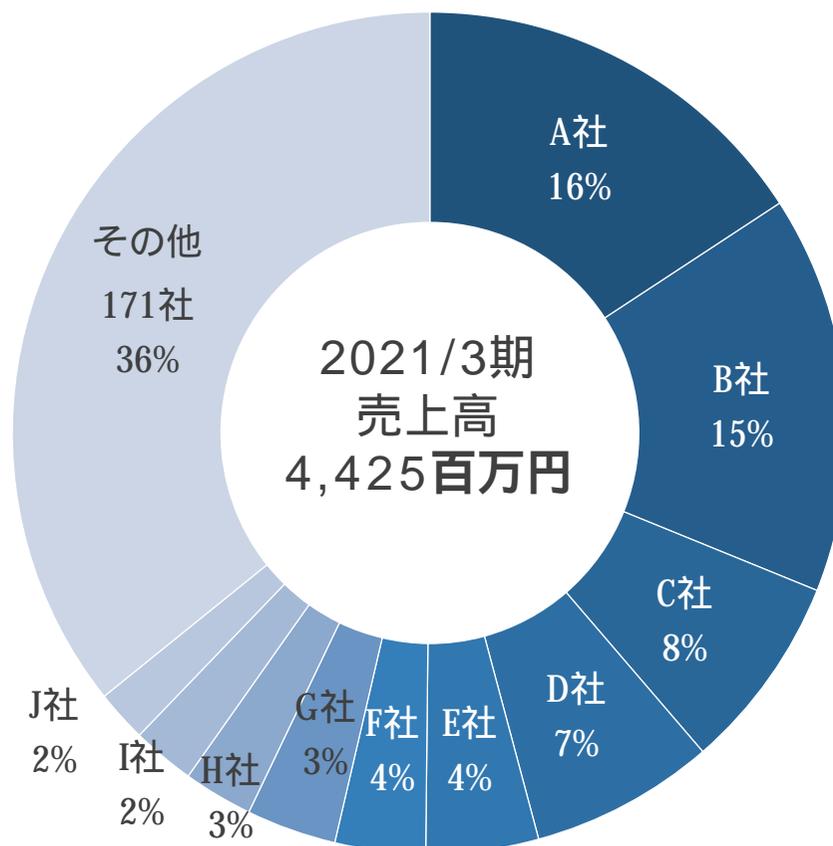
特長のある3つの事業・技術（各種強いアイテムを保有）をコアに、新しい分野に展開



## CASE、5G向けの引き合いが旺盛

\*レガシープロセス：成熟化した技術、品質の高い製品を仕上げるために熟練技術者のノウハウが必要

主要顧客との安定的な取引と販売先の分散が図られた強固な顧客基盤



1. 事業概要
2. 2021年度上期決算の概要
3. 2021年度通期業績予想の概要
4. 今後の成長戦略

## 売上高および各利益とも概ね計画以上の進捗

当社の売上・利益は第4四半期に集中する傾向があり、今第2四半期は軟調を予想していたが、予想を上回る進捗となった。

売上高は、新型コロナウイルス、材料納期遅延の影響を受けたが、2Q計画比増収。経常利益は、高付加価値製品への取り組み、コスト削減の取り組みを行ったことにより、2Q計画比増益。下期のウェイトが高いが、通期での進捗は50.3%と順調。

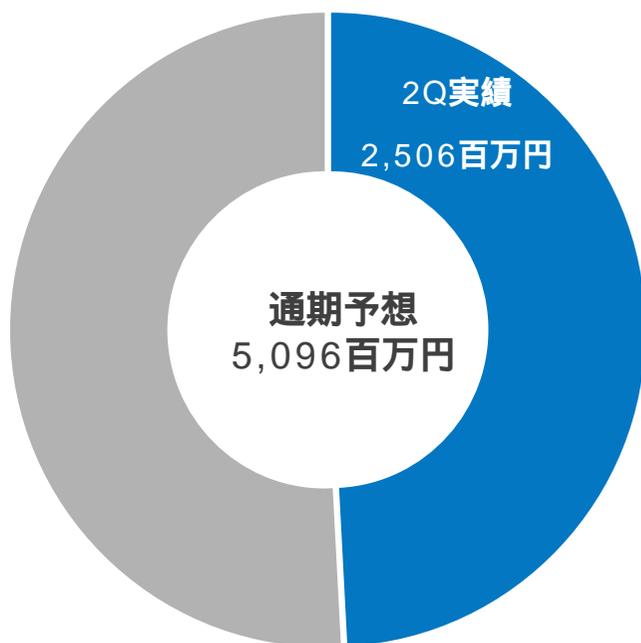
受注は好調であり、業績の上振れ可能性があるが、部品の長納期化の影響を考慮し、業績見通しは据え置く。

(単位：百万円、%)

	2022年3月期 業績予想 (8/11修正)	2022年3月期 1Q (4~6月)	2022年3月期 2Q単独 (7~9月)	2022年3月期 2Q (累計)	業績予想比
	金額	金額	金額	金額	進捗率
売上高	5,096	1,167	1,339	2,506	49.2
営業利益	280	43	87	130	46.5
営業利益率	5.5	3.7	6.5	5.2	—
営業外損益	6	2	11	13	226.7
経常利益	286	44	99	143	50.3
減価償却費合計	122	22	24	47	38.5
当期純利益	200	15	70	85	42.8

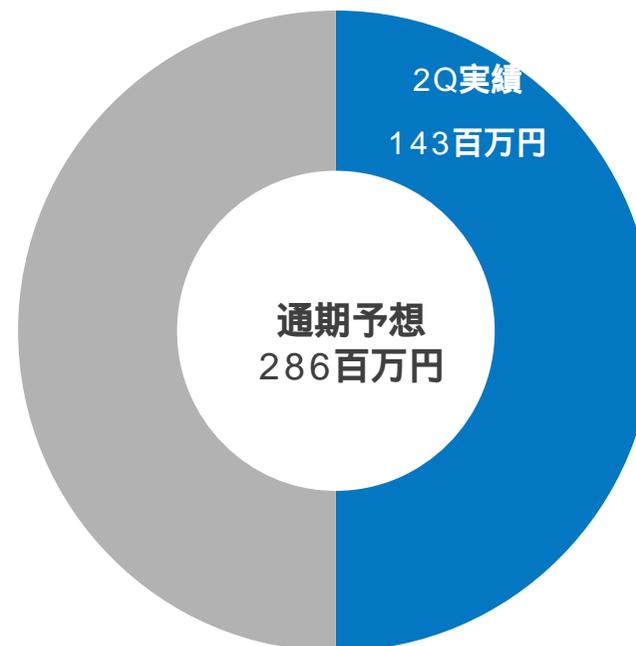
【売上高】

(単位：百万円)



【経常利益】

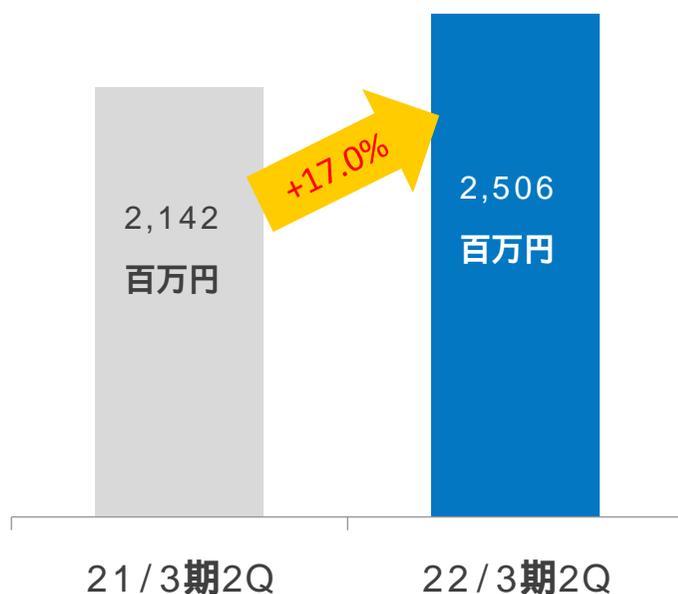
(単位：百万円)



売上高・経常利益ともに4Qに偏重する傾向がある。  
2Qまでの実績は順調に推移

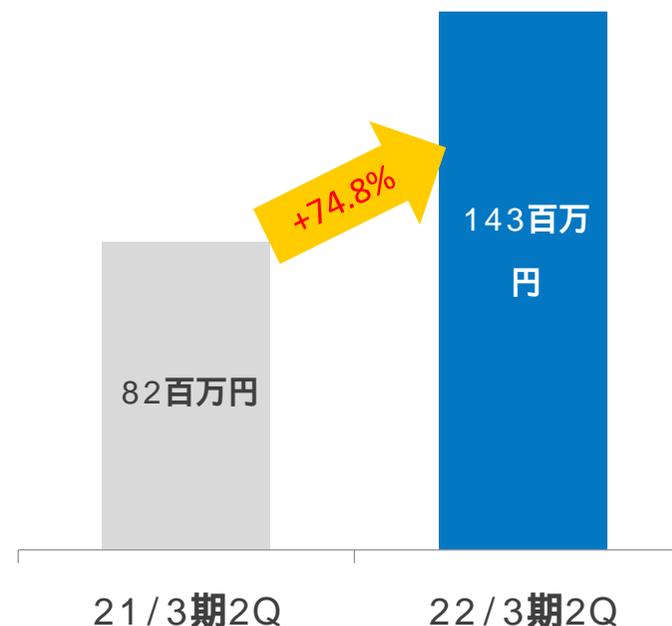
【売上高】

(単位：百万円)



【経常利益】

(単位：百万円)



売上高・経常利益とも前年同期比で増収増益で推移

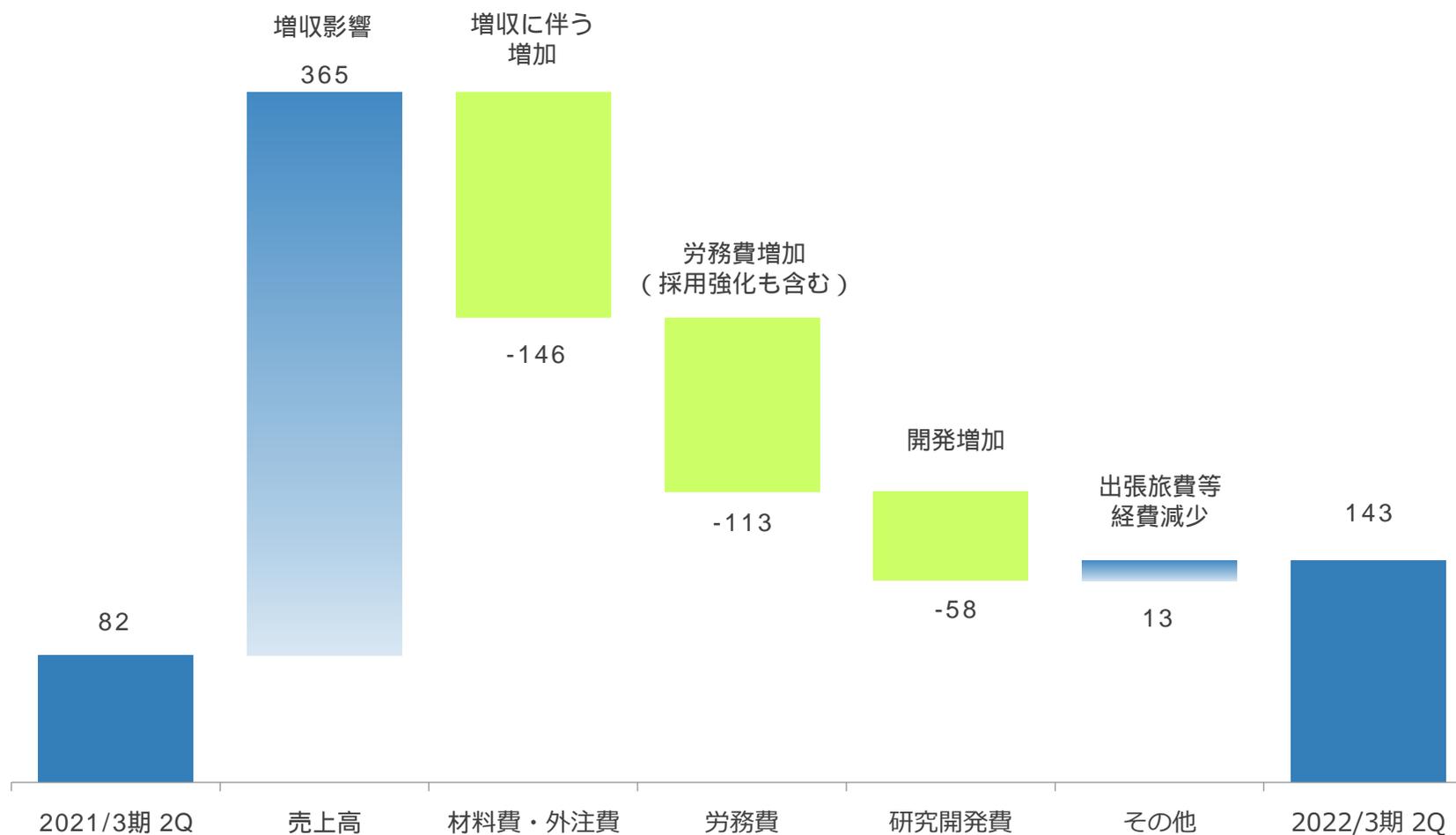
(注) 21/3期2Qは未上場であり、四半期財務諸表を作成しておりませんので、参考数値となります。

# 前年同期（2Q）と比較（経常利益の増減要因分析）

増益要因

減益要因

単位：百万円

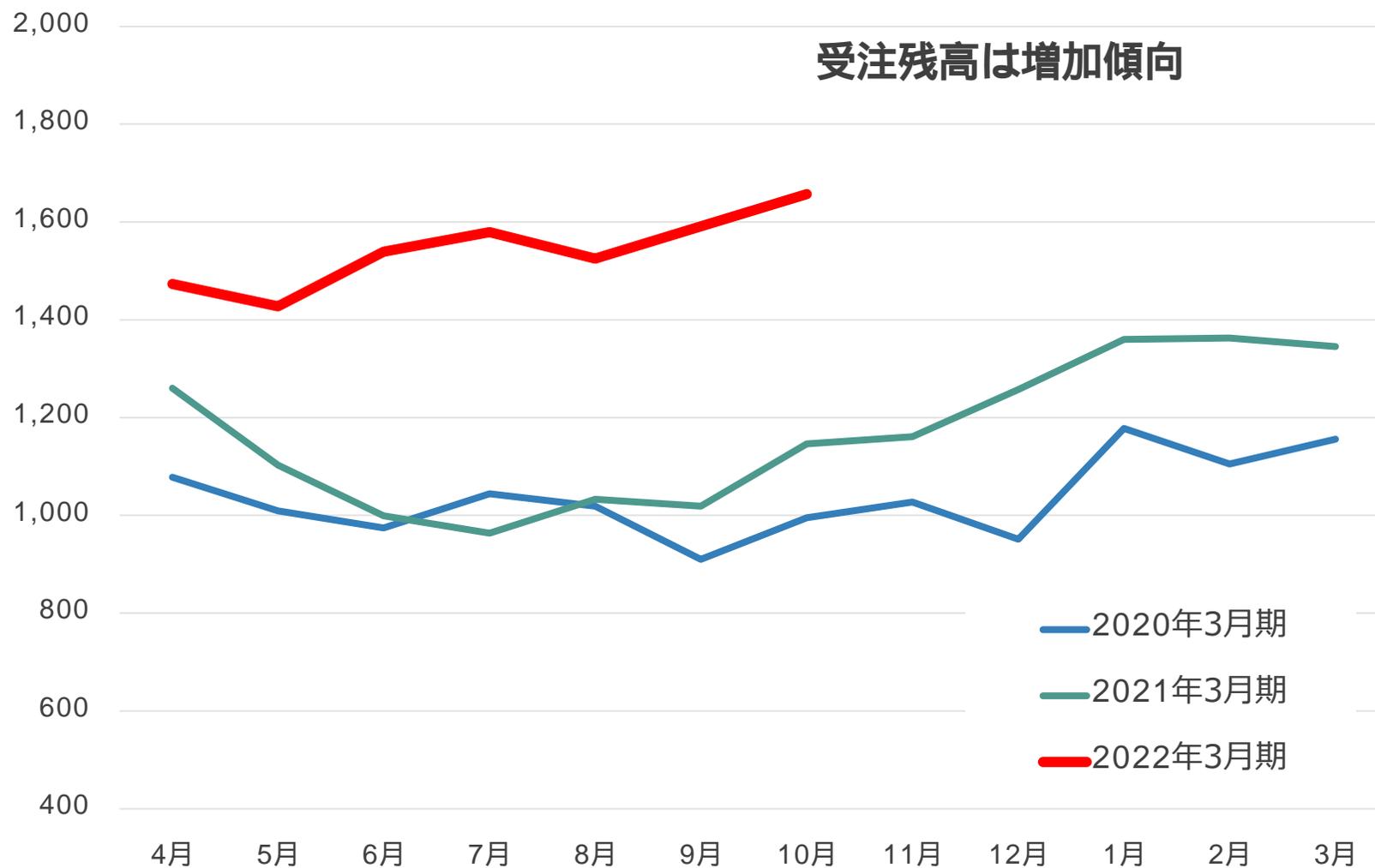


(注) 21/3期2Qは未上場であり、四半期財務諸表を作成しておりませんので、参考数値となります。

経常利益の季節傾向を明確にするため、経常利益のスケールを調整しています。

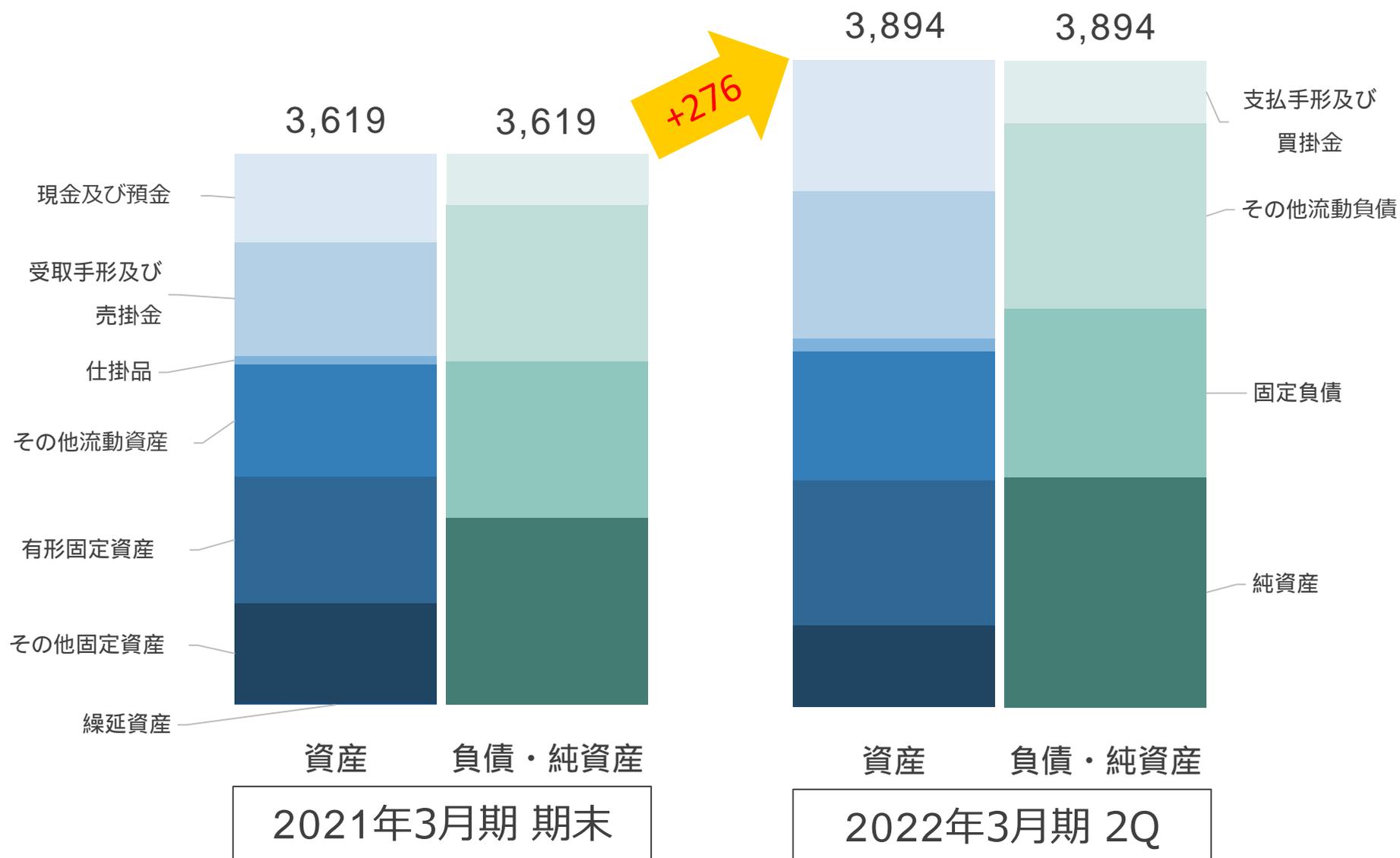
【受注残高(全社)】

(単位:百万円)



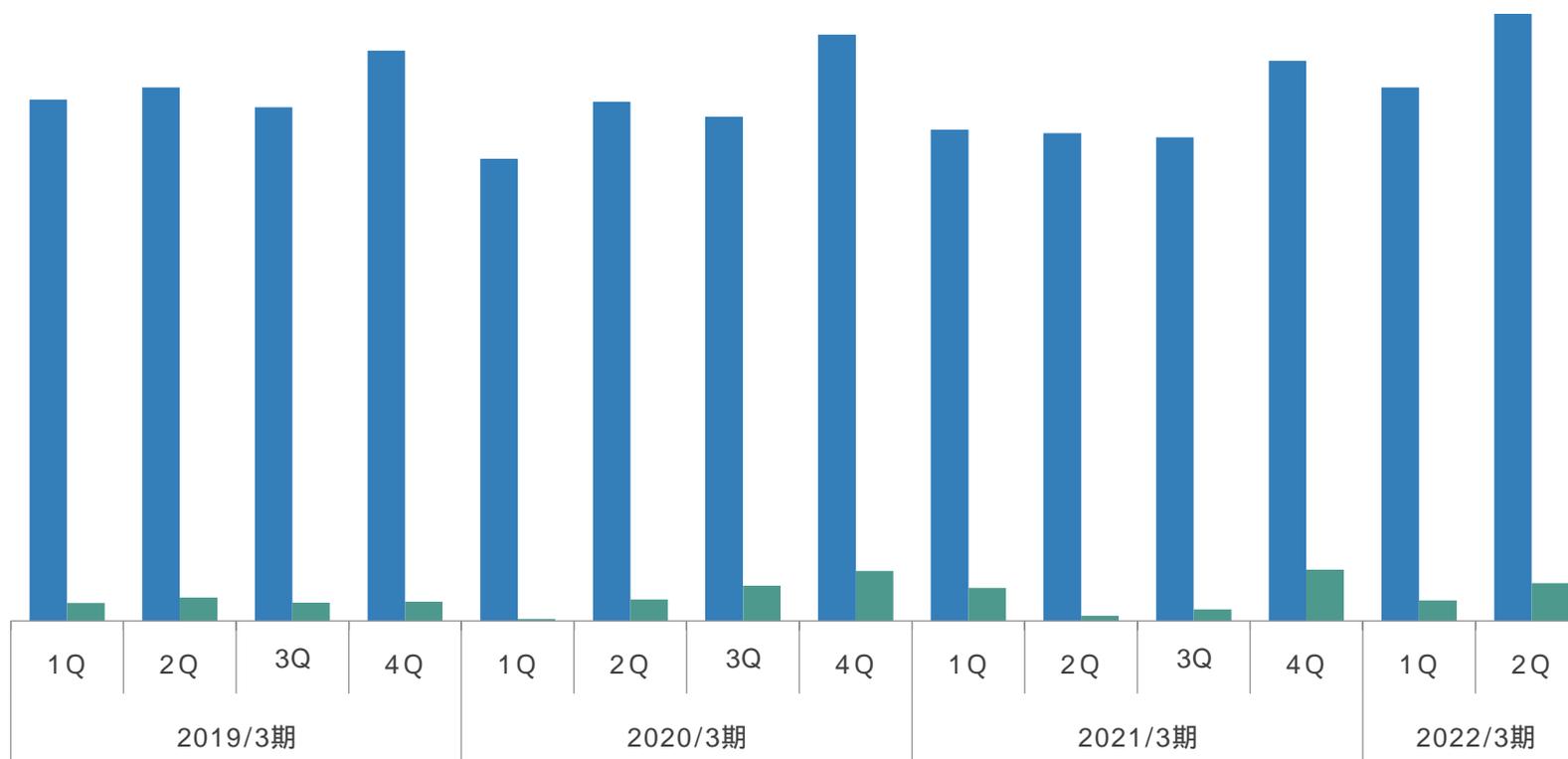
# 貸借対照表

(単位：百万円)



顧客のプロジェクト（製品開発等）サイクル、当年度の量産開始が下期から開始する傾向などにより、売上・利益ともに4Qが最も高くなる傾向

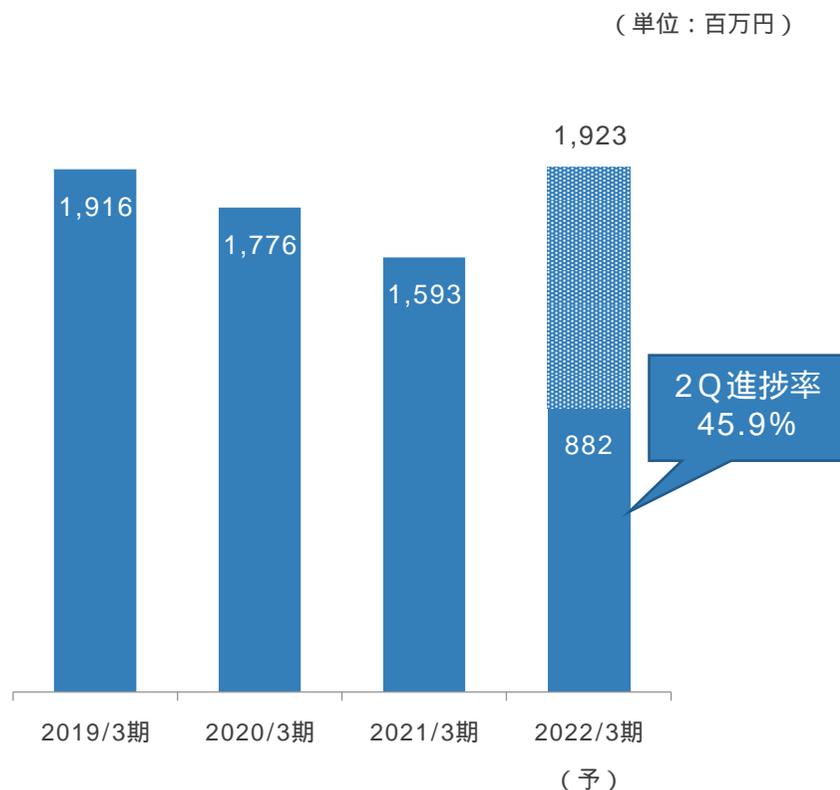
■ 売上高 ■ 経常利益



経常利益の季節傾向を明確にするため、経常利益のスケールを調整しています。

計測・制御・通信をコア技術に、開発～ものづくり～保守・メンテナンスまでトータルで半導体検査装置・産業機器を提供

## 【売上高】



## 2Qトピックス

### ➤ IoT-PLC通信モジュール

- ・ 広帯域電力線搬送通信設備型式指定を取得
- ・ HD-PLCアライアンス加入
- ・ 高速電力線通信推進協議会加入
- ・ 製品市場投入、顧客サポート開始
  - 評価機貸出し
  - 周辺機器カスタム開発
  - 応用製品POC受託開発
- ・ 次世代標準モデル開発検討着手



### ➤ バーンイン装置

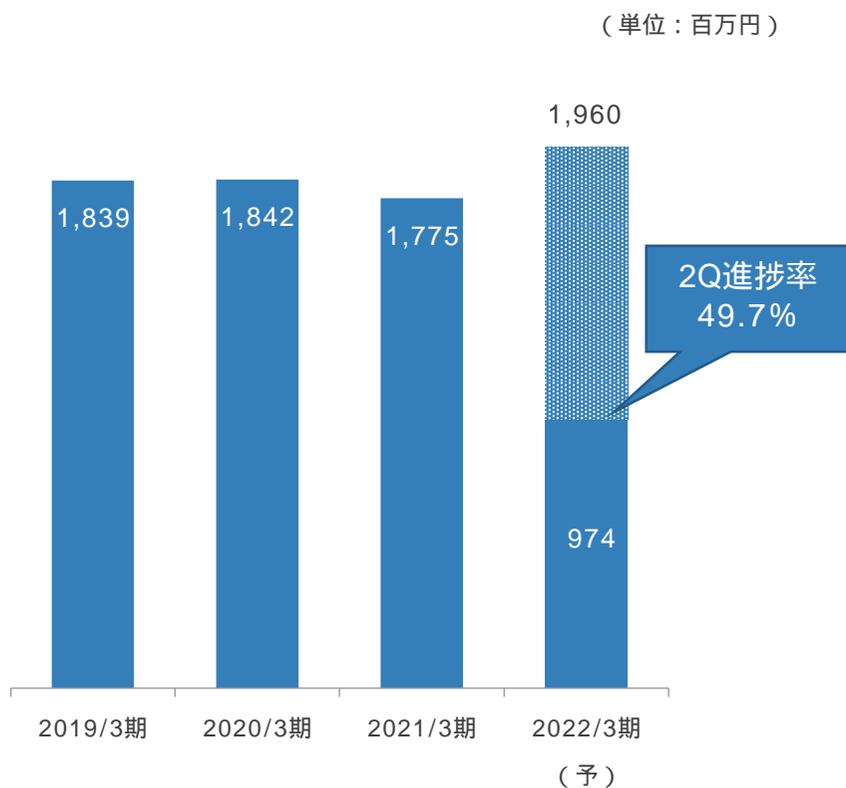
- ・ リース機増大・拡充
- ・ 受託試験適用デバイス範囲拡大
- ・ 中古装置事業本格開始



高速インターフェース技術、電源技術、画像処理技術を強みにモバイル、車載機器分野などに向けた半導体のアナログ設計、デジタル設計及びIPコアや評価サービスを提供

## 2Qトピックス

### 【売上高】

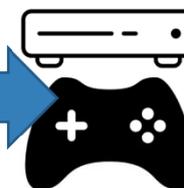


#### ➤ アナログ半導体設計受託

スマートフォン向けセンサ関連  
アナログ設計受託  
(前年下期比：114%)



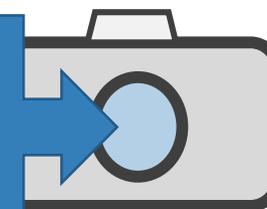
汎用商品向けパワー半導体関連  
アナログ設計受託  
(新規受託)



#### ➤ デジタル半導体設計受託

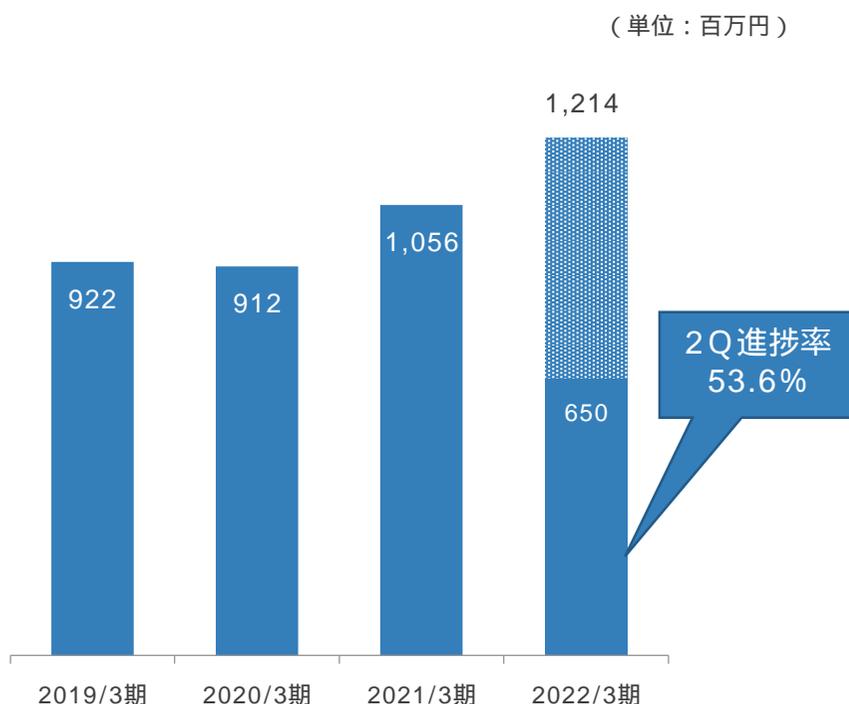
画像処理関連LSIの設計受託が堅調に推移  
大型案件を受注

DSC向け画像処理関連  
デジタル設計受託  
(前年下期比：428%)



コンビニATM等社会インフラ分野から応用製品（医療・介護関連：ビュー+センシング）へ展開  
組み込みカメラシステム分野での光学・電子回路・ソフトウェアトータルでの技術力が強み

## 【売上高】



## 2Qトピックス

### ➤ ヘルスケア産業育成創出事業 採択

- ・採択機関：公益財団法人 富山県新世紀産業機構
- ・テーマ名：機械学習を用いた、廉価 / 高性能 見守りシステム向け遠赤外線体表面温度推定の精度向上に関する研究
- ・採択時期：2021年8月～2022年2月

### ➤ オンライン販売ショップ「チップワンストップ」にてカメラ製品の取り扱いを開始

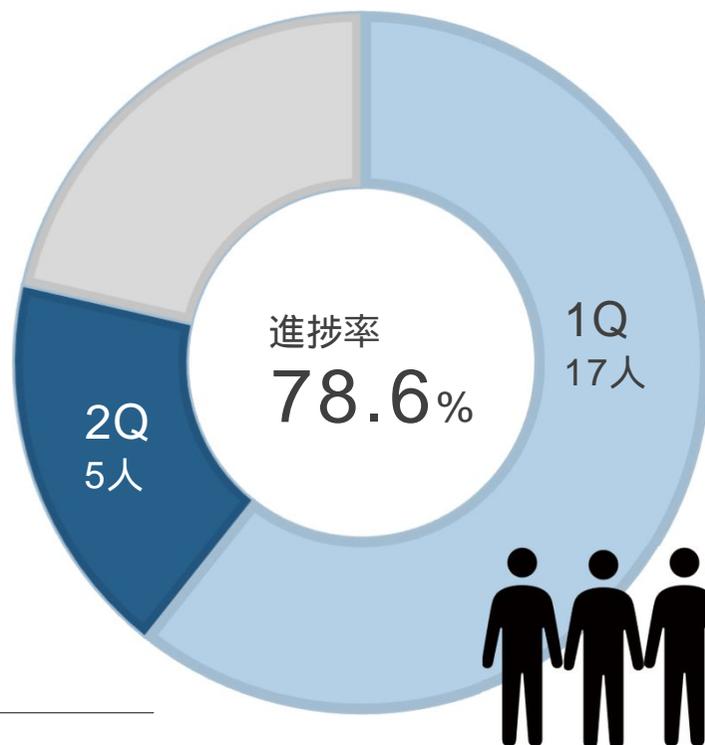
- ・オンライン販売先：株式会社チップワンストップ  
日本国内最大級の電子部品通販サイト  
[www.chip1stop.com](http://www.chip1stop.com)
- ・取り扱い製品名：KBCR-S03TU  
200万画素高感度USBカメラ
- ・取り扱い開始時期：2021年9月
- ・WEBセミナー登壇：同社主催「エッジAI 2021」にて  
画像センシングカメラを講演



半導体事業における増産に対応するため、  
人員増強を図る。  
通期で28人の計画に対し、2Qまで22人  
増員。

人員

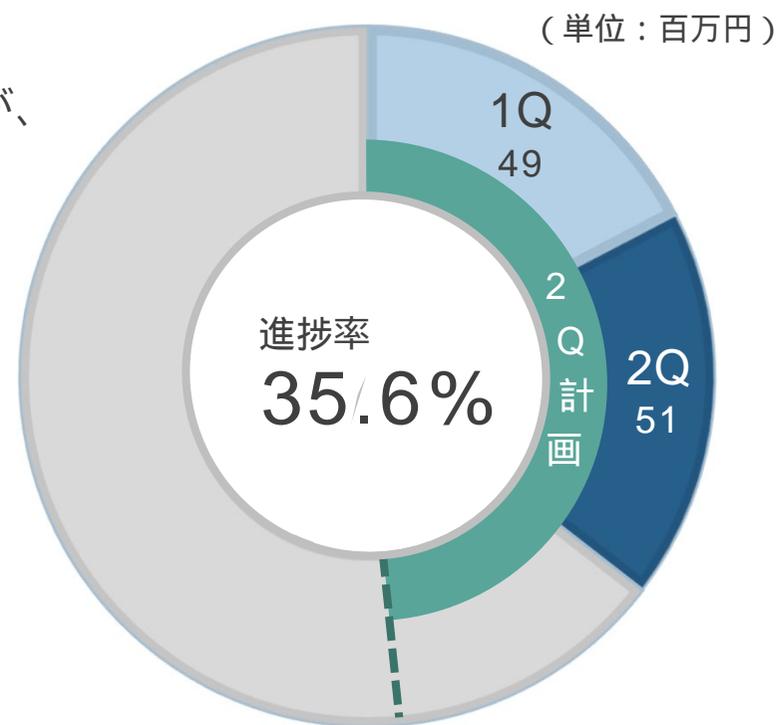
通期計画：28人



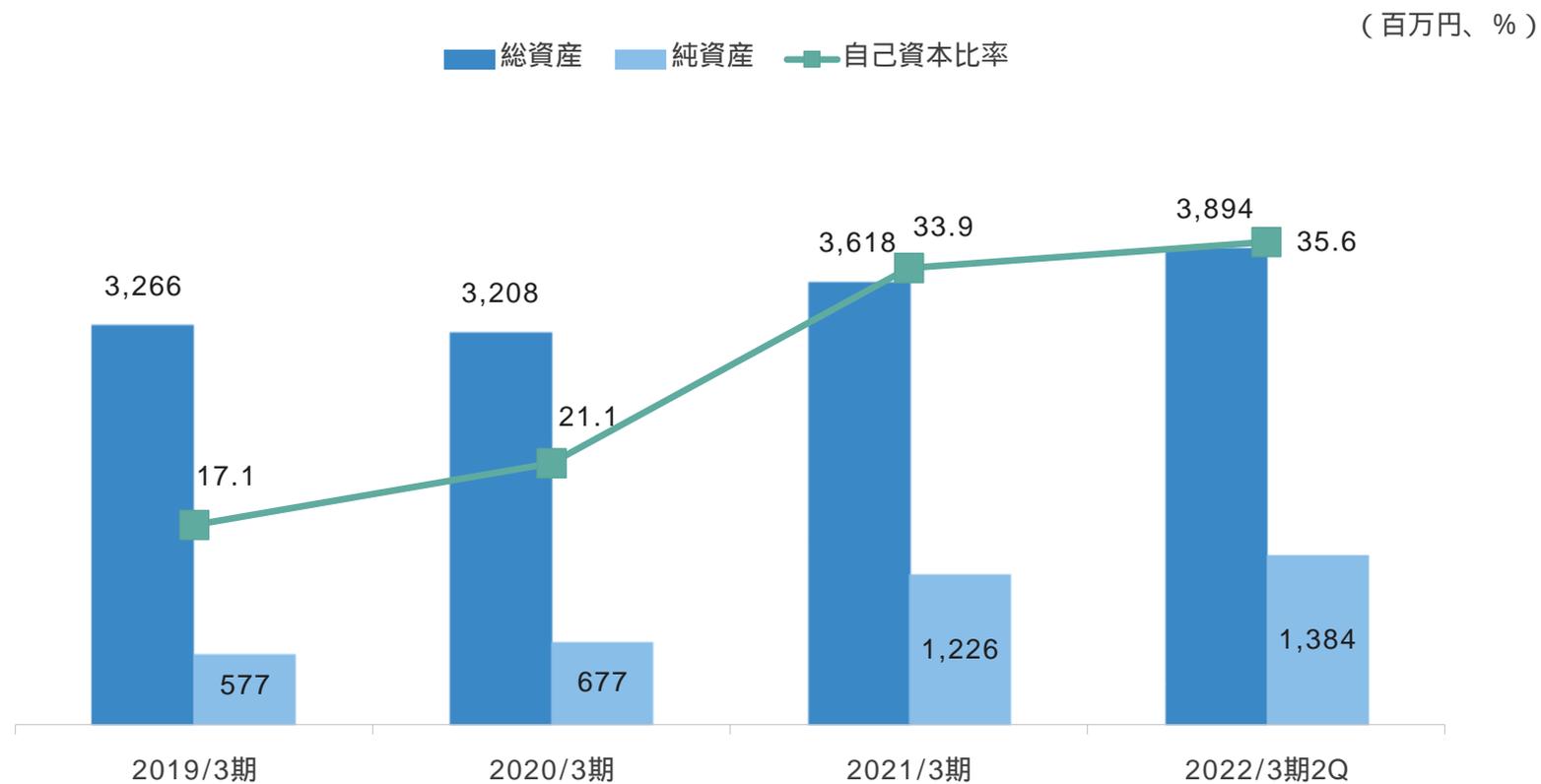
開発テーマの入れ替え、早期事業化により  
年間の研究開発費投下の進捗が遅く見えるが、  
大幅な遅れは生じていない。

## 研究開発費

通期計画：282  
(うち、2Q計画：139)



## 自己資本比率は上昇基調で推移



1. 事業概要
2. 2021年度上期決算の概要
- 3. 2021年度通期業績予想の概要**
4. 今後の成長戦略

## 2021年度通期業績予想の概要

**売上高15.2%増、営業利益は37.8%増、経常利益36.7%増、当期純利益76.6%増を予想**

半導体の需給逼迫状況は、現状と同水準が年度を通じて継続することを想定  
 顧客の生産動向は、緩やかな回復基調を見込む  
 次年度以降の成長戦略達成に向け、開発を加速するため研究開発費を増額  
 規模拡大に向け、採用を拡充し人財増強（前期比28名増）

(単位：百万円、%)

科目	2021/3期 実績		2022/3期 予想		前期比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減	増減率
売上高	4,425	100	5,096	100	670	15.2
営業利益	203	4.6	280	5.5	77	37.8
経常利益	209	4.7	286	5.6	77	36.7
当期純利益	113	2.6	200	3.9	87	76.6

## 電子システム事業

半導体検査商材の受注増及び新分野（センサー、光など）での拡販  
車載製品向けの取引回復を見込む

中古販売や検査受託、保守・メンテナンスの強化により受注範囲拡大を図る

売上高：前期比 + 20.7%

## マイクロエレクトロニクス事業

5G関連領域での一層の受託拡大  
米中貿易摩擦の影響一巡で画像、イメージセンサ分野での受託回復を見込む

JPEGとISPのIP開発強化と  
グローバル販売への取り組み推進

売上高：前期比： + 10.4%

## 製品開発事業

産業機器分野、医療分野への一層の取り組みを強化

センシングカメララインナップの強化と市場開拓推進、

AIカメラでのセンシング技術強化

医療・介護分野での完成品への取り組み

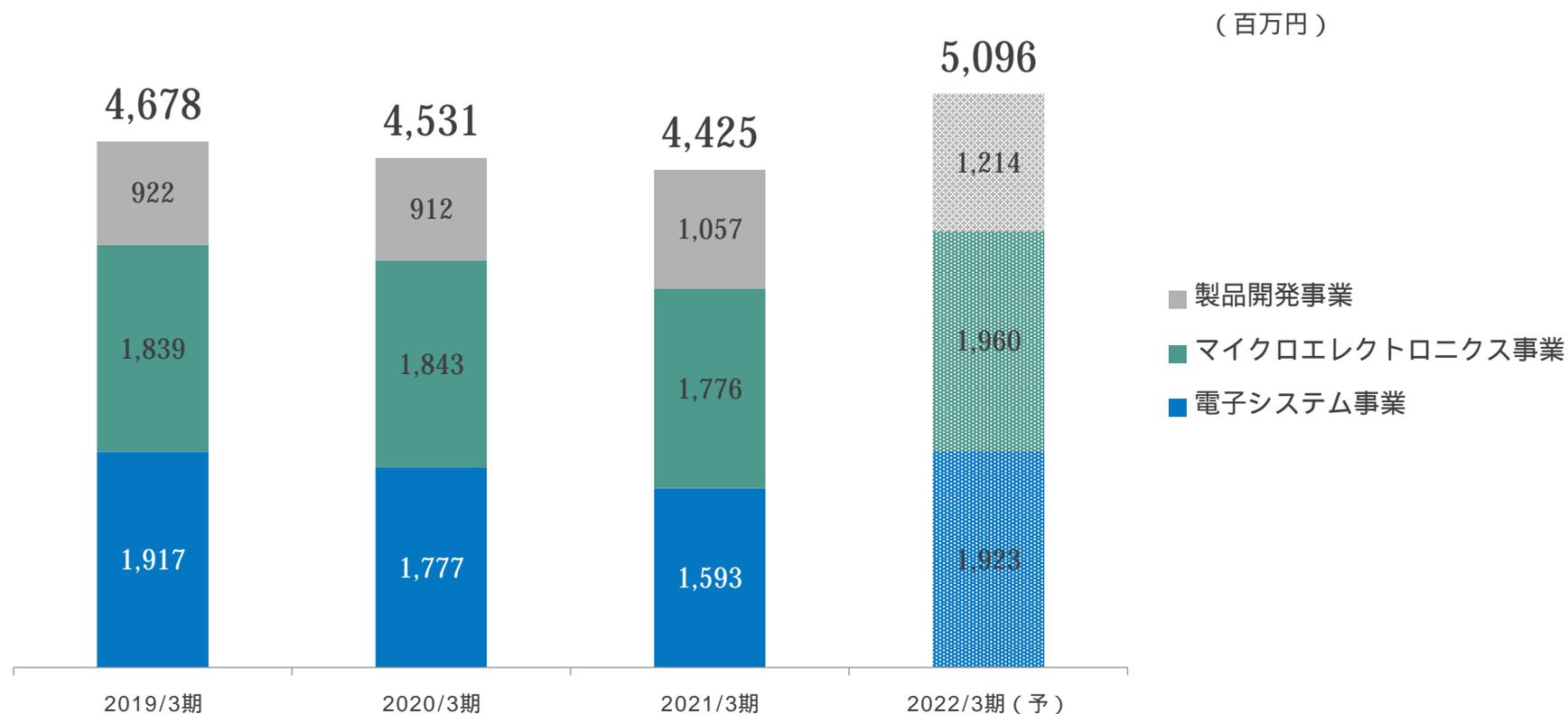
売上高：前期比： + 14.9%

収益を伴う成長戦略の加速

# 売上高の推移

2021/3期は、新型コロナウイルス、米中貿易摩擦の影響から、電子システム事業とマイクロエレクトロニクス事業が伸び悩むも、製品開発事業は増収

2022/3期は、半導体需要増加に伴い電子システム事業は回復、マイクロエレクトロニクス事業は米中貿易摩擦の影響一巡により回復、製品開発事業は更に増収を予想



# 経常利益・当期純利益の推移

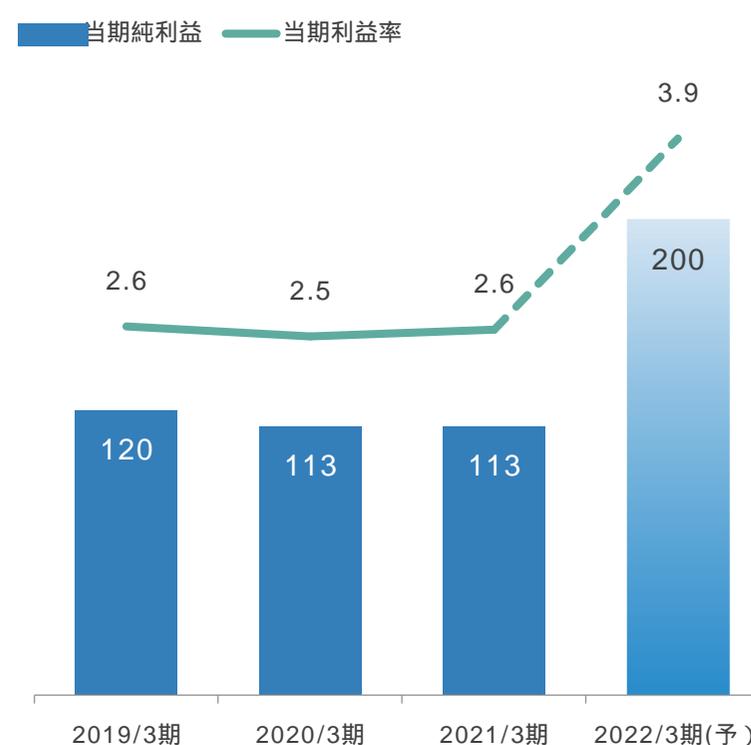
2021/3期は新型コロナウイルスの影響を受けた減収影響や上場関連費用増により減益  
2022/3期は、増収増益を予想するが、次年度以降の成長に向けた人財を増強すると共に、研究開発費を大幅に積み増しする

(百万円)

### 【経常利益】



### 【当期純利益】

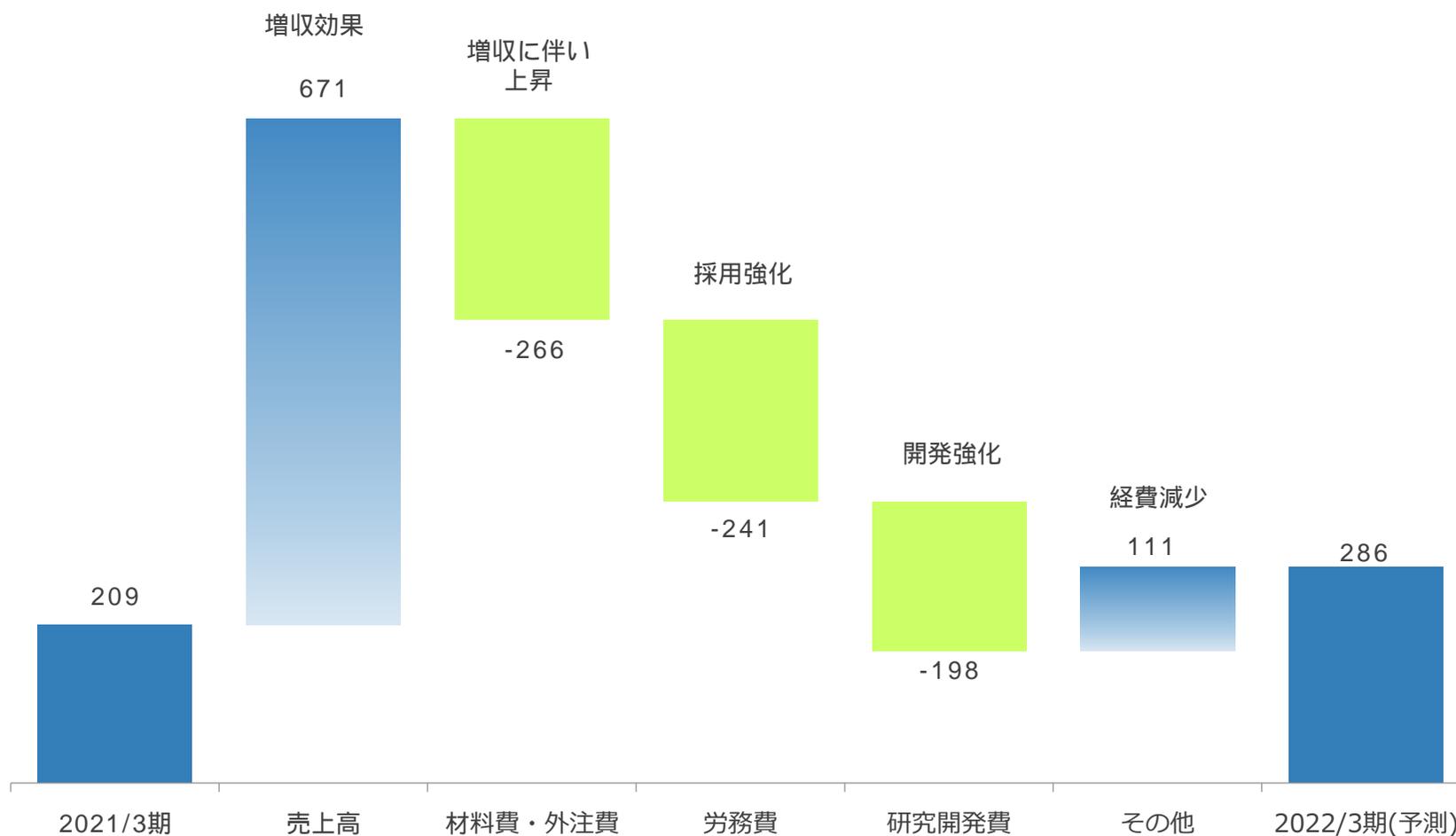


# 前期と業績予測の比較（経常利益の増減要因分析）

増益要因

減益要因

単位：百万円



経常利益の季節傾向を明確にするため、経常利益のスケールを調整しています。

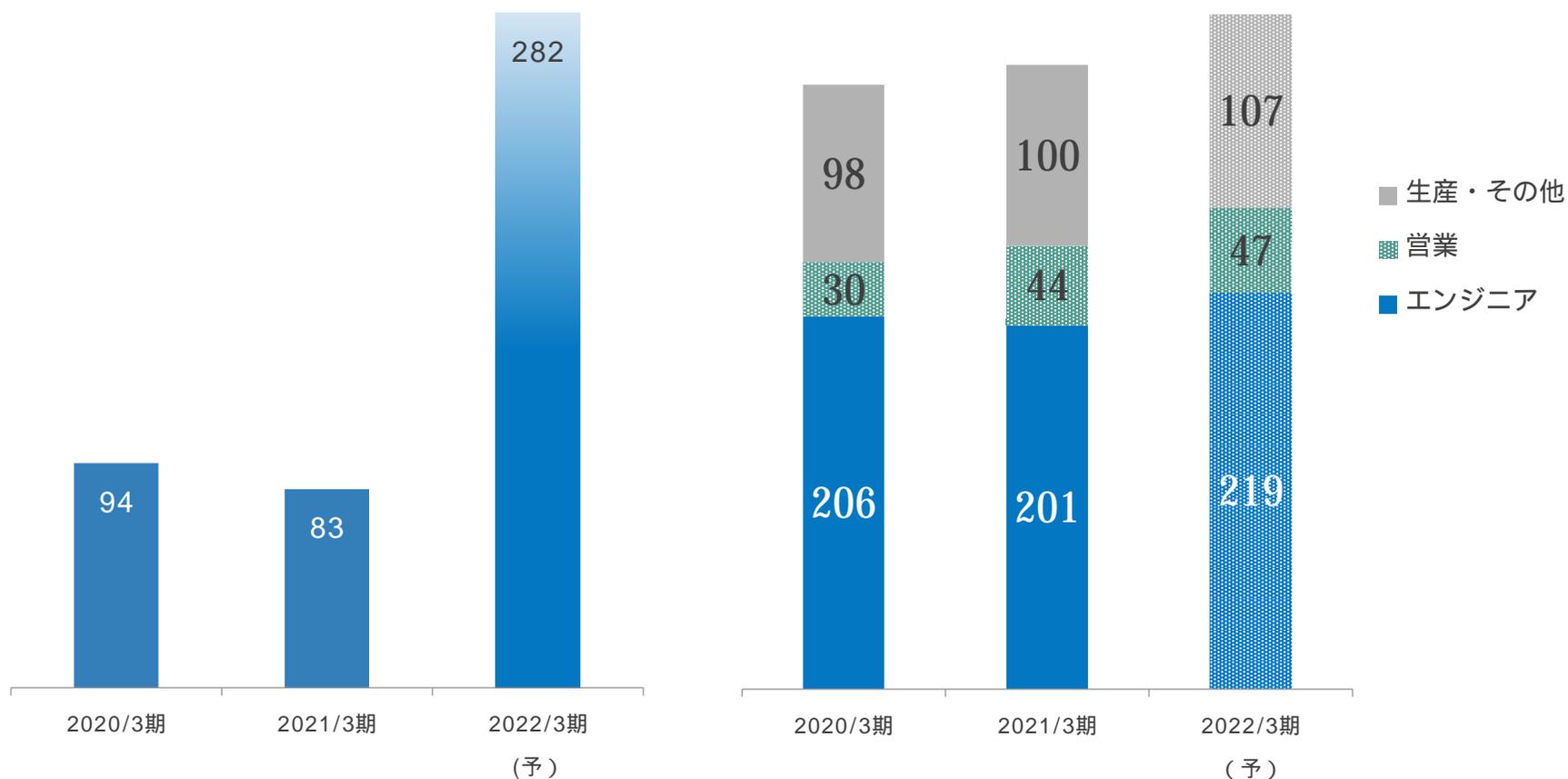
# 研究開発費・従業員数

2022/3期は次年度以降の成長に向け、研究開発費の増額を計画するとともに、主に技術を中心に28名の人財を増強予定

【研究開発費】

【従業員数】

(百万円)



顧客の未解決課題の解決、顧客ニーズの充足の視点で、競合他社に対して  
優位性のある技術・製品の開発に取り組む

## 研究開発分野

半導体検査装置、計測システム、  
IPコア、高速I/F回路、  
画像処理システム、カメラの性能向上、  
新機能開発

### 電子システム事業

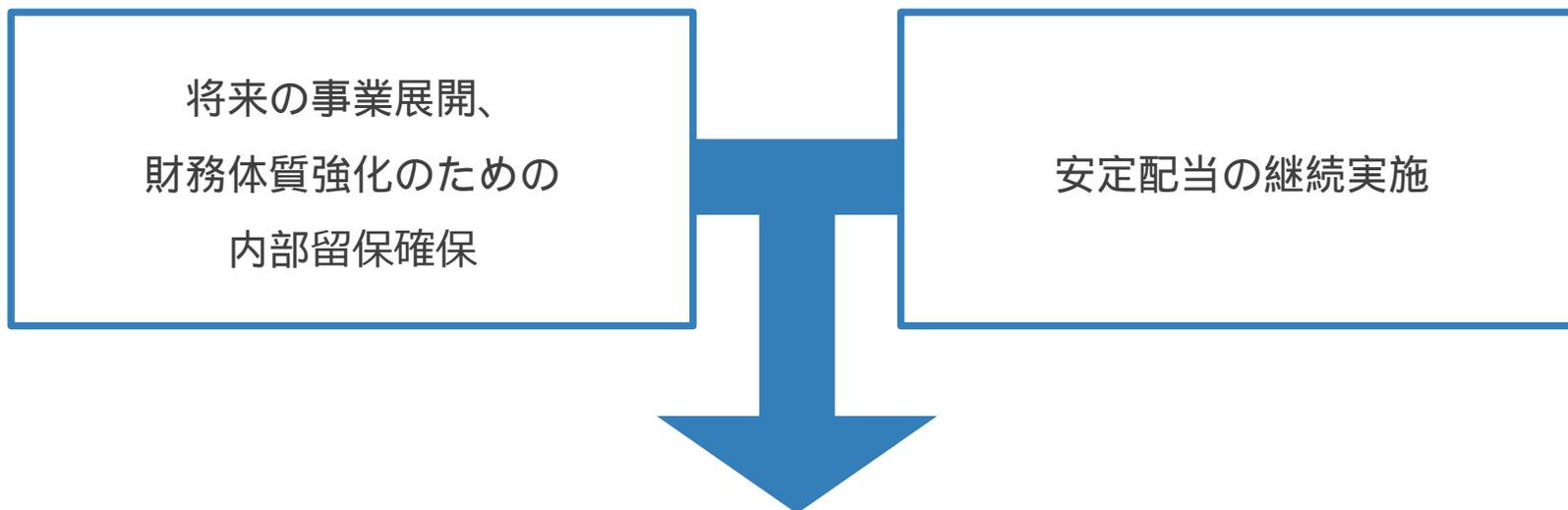
・半導体検査装置・カスタムBI装置・HD-PLC

### マイクロエレクトロニクス事業

・JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア

### 製品開発事業

・エッジAIカメラ・高画素インテリジェントカメラ・介護向けシステム

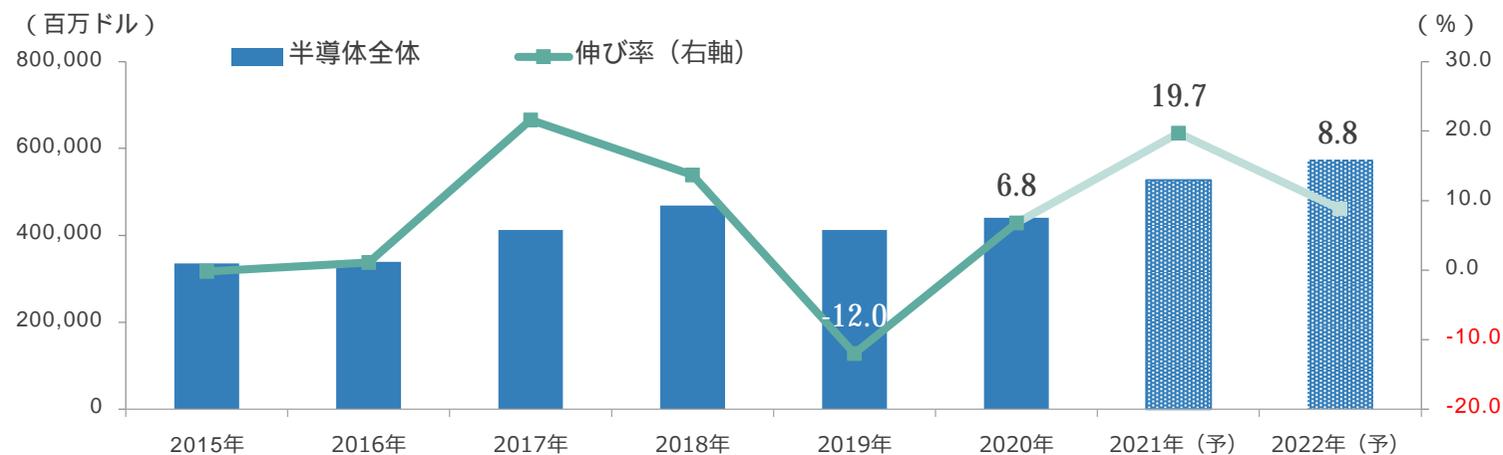
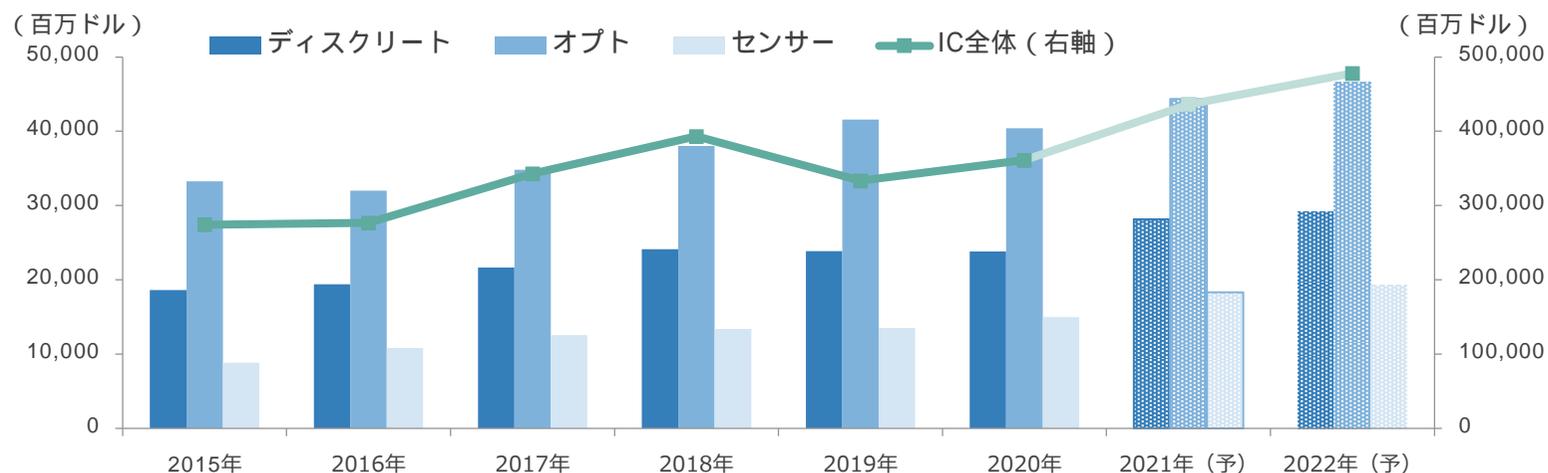


## 株主への利益還元を重視した経営を推進

内部留保の充実による一層の事業拡大（優秀な人財の確保、新技術導入、独自製品開発に向けた投資）による企業価値向上      株主への利益還元の最大化

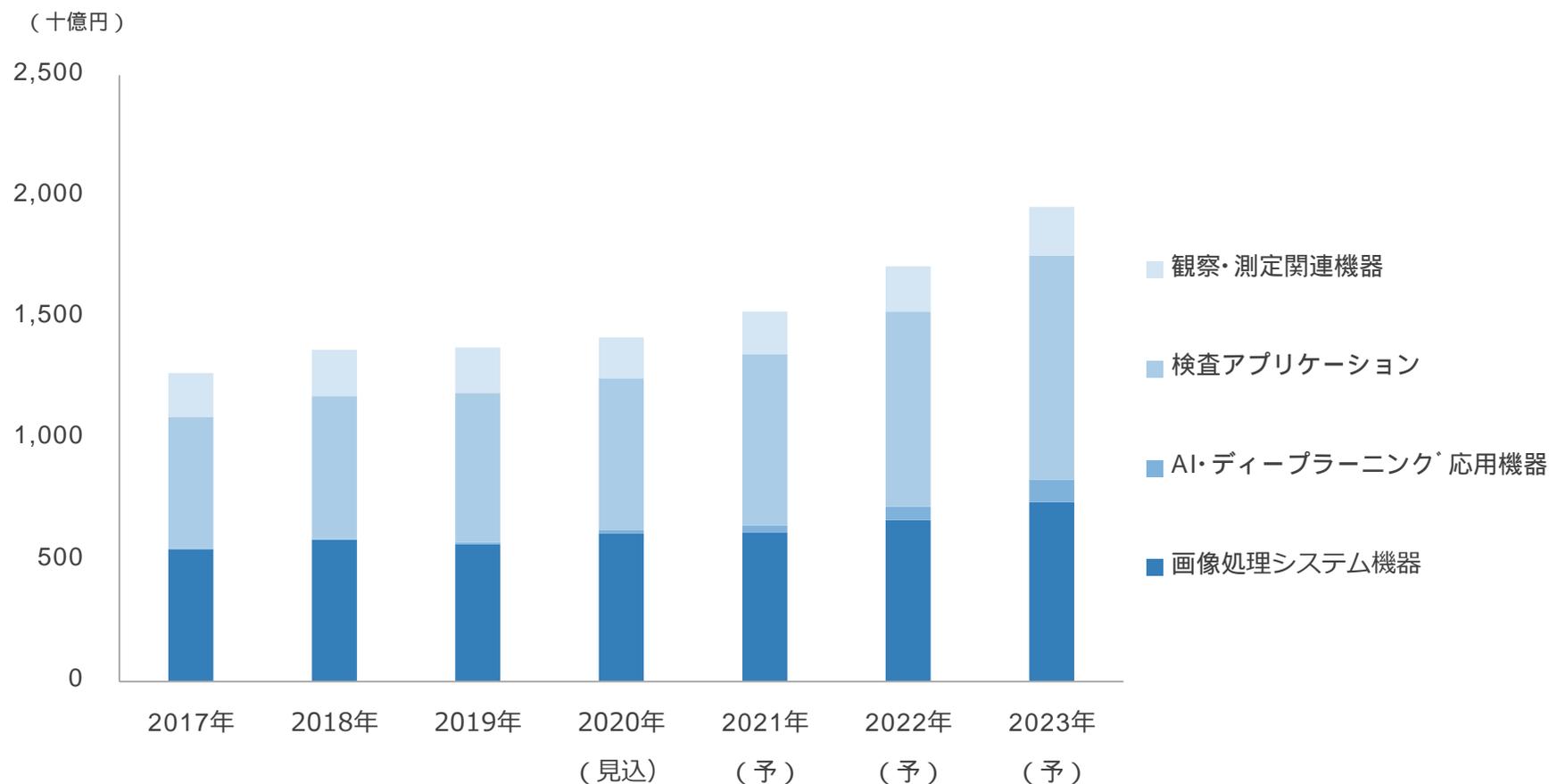
1. 事業概要
2. 2021年度上期決算の概要
3. 2021年度通期業績予想の概要
4. 今後の成長戦略

世界半導体市場は、新型コロナウイルスの影響により、パソコン・タブレット、5G関連、データセンター関連機器等巣籠り需要等、半導体をけん引した要因が継続し2桁成長予測  
半導体全体では、2021年に前年比+19.7%、2022年に前年比+8.8%を予測



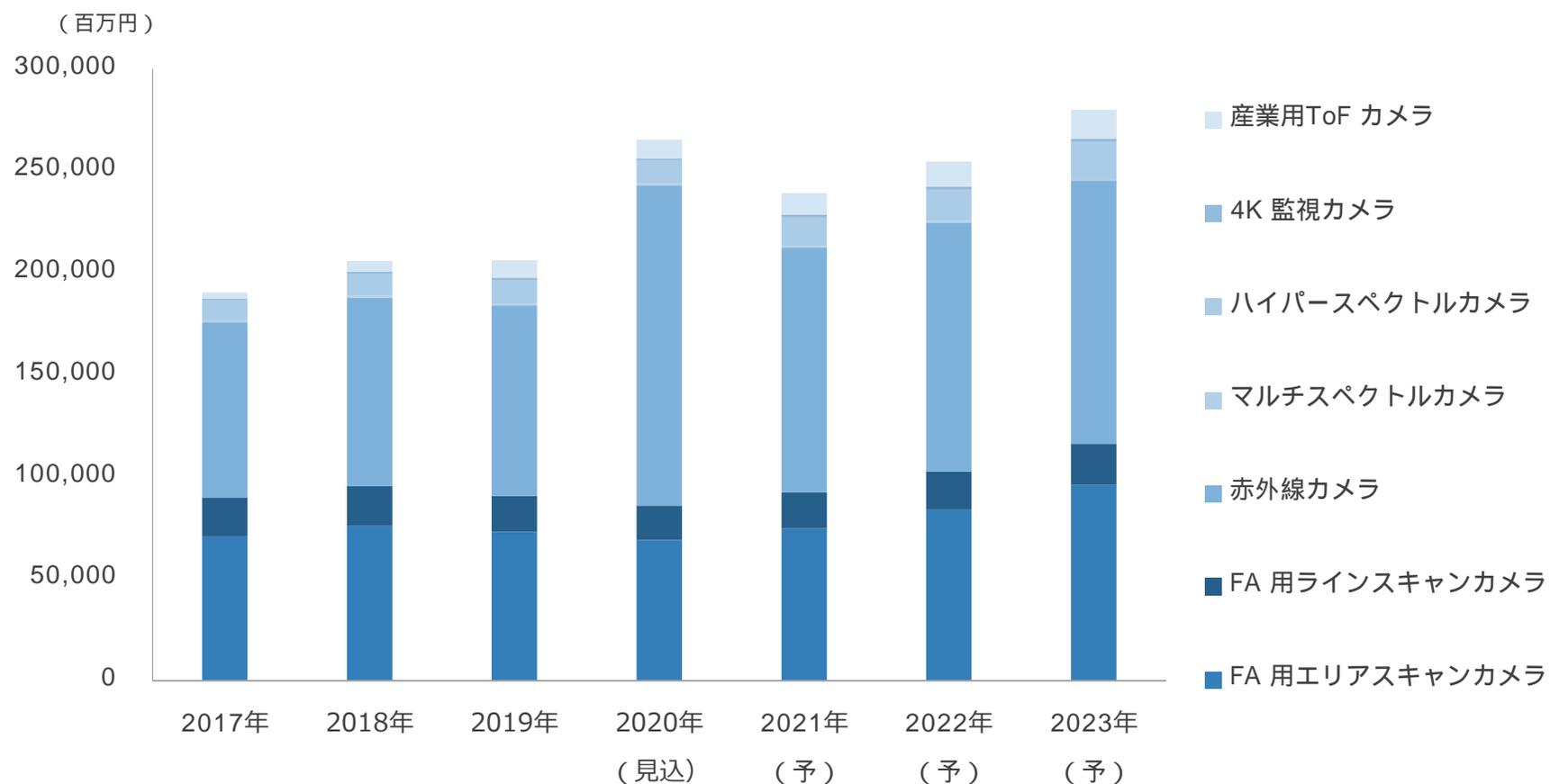
出所：WSTS (WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS：世界半導体市場統計) 2021年春季半導体市場予測より当社作成

画像処理システム市場は、画像処理システム機器を主体に堅調に推移していたが、AIの応用機器の飛躍的な成長率と検査アプリケーションの堅調な成長を中心に成長加速の予測  
 検査アプリケーションは、2021年に前年比+12.8%、2022年に前年比+13.7%を予測



出所：株式会社富士経済「画像処理システム市場の現状と将来展望」より当社作成

2020年は、新型コロナウイルスの影響による体温検知用赤外線カメラが一時的に増加。  
 センサーの高性能化、AIの導入によりカメラ適用分野が拡大し、着実な成長を予測



出所：株式会社富士経済「画像処理システム市場の現状と将来展望」より当社作成

車載関連、5G、ロボット、AI等の需要拡大（AI+IoTものづくり）に対応

## 中核事業の競争力強化

電子システム事業・・・BIソリューション（スクリーニング）の受注範囲拡大

マイクロエレクトロニクス事業・・・アナログを強化し新分野への展開、デジタルをソフトウェアで強化

製品開発事業・・・医療関連機器・産業機器への事業領域拡大による販売拡大と利益率改善

## 新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

電子システム事業・・・新機能付きバーンイン装置の開発

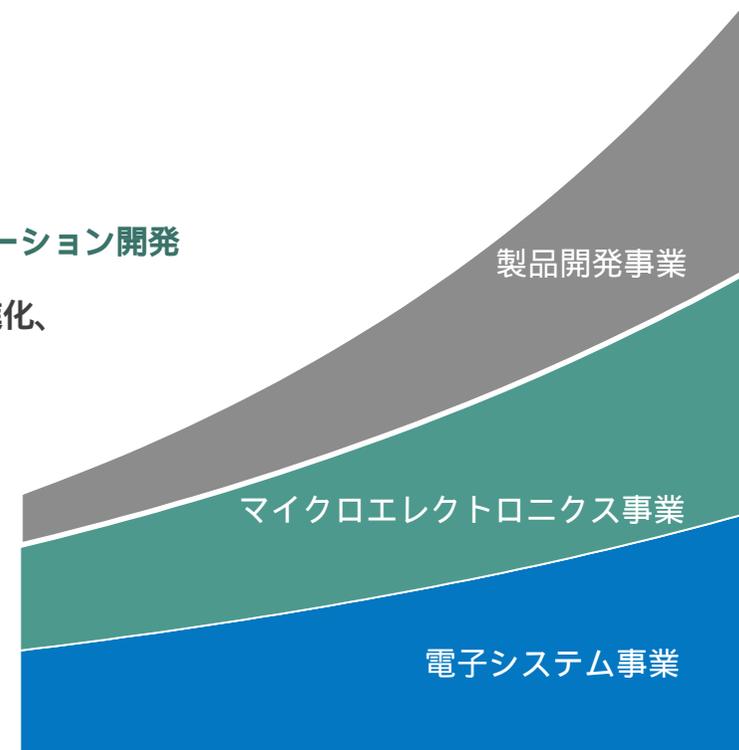
マイクロエレクトロニクス事業・・・JPEGの進化とAI & ISPのソリューション開発

製品開発事業・・・AI技術導入しセンシングカメラ進化、  
画像応用製品での事業化推進

## 新市場、グローバル戦略の拡大

電子システム事業・・・OSATを足掛かりにした海外展開

マイクロエレクトロニクス事業・・・JPEG、画像関連製品の  
グローバル展開



電子システム事業・マイクロエレクトロニクス事業の売上拡大・利益率向上  
先端技術を追求、ニッチ市場での圧倒的シェア獲得を目指す

## ✓ BIソリューション（スクリーニング）の受注範囲拡大



BIシステムのレンタル、中古販売による販売増、アフターメンテナンス業務の拡大  
関連分野の受託検査業務（開発工程、製造工程）に注力

## ✓ 製造ラインの省人化・省力化の継続的な取り組みによる一層の生産性向上、業務改善の推進

## ✓ アナログLSI設計の技術力強化（人財・上流設計）による付加価値向上、存在感アップ

利益率向上

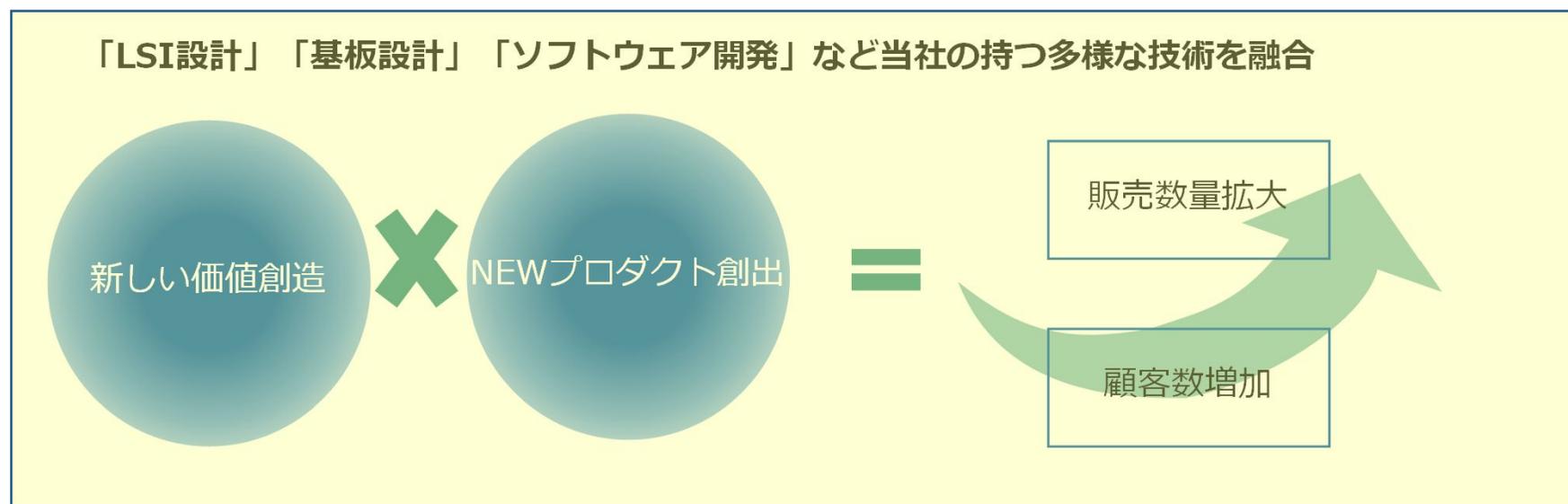


設計品質・製造品質・  
サービス品質の向上、  
信頼性確保



製品ラインナップの拡充による顧客層の拡大（ビジネスアイテム追加）

- ✓ カスタムBI装置（BIソリューション）の開発 センサー、光分野への拡大
- ✓ JPEG新規格の開発、AI & ISPのソリューション開発



- ✓ 設計技術力を活かした1チップ開発への取り組み
  - ✓ カメラ + 応用製品（センシング等）の展開
- 産業用ロボットを含めたIoT関連分野  
車載、医療、通信分野のビジョンソリューション

電子システム事業における、OSATを足掛かりにした海外展開

OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test: 後工程のアセンブリとテスト工程を請負会社)

マイクロエレクトロニクス事業でのJPEG、画像関連製品のワールドワイド展開



## ご清聴ありがとうございました

本資料および決算説明会で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは大きく異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

### 【お問い合わせ先】

株式会社シキノハイテック

常務取締役管理本部長 広田 文男

e-mail : IR-contact@shikino.co.jp

TEL : 0765-22-3477 FAX : 0765-22-3916

ホームページ : <https://www.shikino.co.jp/>

# APPENDIX



バーンイン（ボード）	バーンインは、半導体の初期不良を除去する選別方法の1種。バーンインボードは、通常の使用環境であれば2～3年以内で故障するおそれのある半導体を取り除くテスト工程（パッケージバーンインテスト）で用いられる基板。半導体製品の動作を検証、初期不良品を選別。
LSI	大規模集積回路。ICのうち、素子の集積度が1,000個～10万個程度のもを「MSI」（Medium Scale Integration）、1万ゲート位までのものを「LSI」と呼ぶ。これ以上はVLSI（Very Large Scale Integrated Circuit）と呼ばれている
IC	半導体集積回路。トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ダイオードなどの素子を集めて基板の上に装着し、各種の機能を持たせた電子回路。（Integrated Circuit）
I/F回路（アイエフ回路）	受信機・通信機において周波数変換された信号を処理する電子回路。
FPGA	プログラムすることができる論理LSI。マイクロプロセッサやASIC（特定用途のために設計されたIC）の設計図を送り込んでシミュレーションすることが可能。（Field Programmable Gate Array）
ASIC	特定の用途のために設計されたIC。フルカスタムICは注文に応じてゼロから設計、セミカスタムICはあらかじめ特定の機能を持った回路ブロックを組み合わせた「半完成品」をもとに、配線を変えることで要求に合わせたもの。（Application Specific Integrated Circuit）
JPEG	静止画像データの圧縮方式の一つ。圧縮の際に若干の画像劣化を許容する（劣化許容レベルの指定が可能）方式と、まったく劣化のない方式を選ぶことが可能、現在のデジタルカメラのほとんどは、記録画像のファイル形式にJPEGを使用。（Joint Photographic Experts Group）
IP	再利用可能な設計資産（知的財産）。ICの設計と製造の分業化により、IPが独自の市場を形成。（Intellectual Property）
MIPI	企業団体MIPI Alliance（本部米国：ノキア、テキサス・インスツルメンツ等により設立）が策定する、モバイル機器のカメラやディスプレイとのインターフェイス規格。（Mobile Industry Processor Interface）
CMOS	半導体の一方式であるMOS（半導体の中で動いている自由電子が、自由電子が飛び出した後の正孔のいずれかによって電荷が運搬されるトランジスタ）を改良したもので、電荷の運搬に自由電子と正孔の両方を用いるため、MOSに比べて動作速度が高い特徴があります。（Complementary Metal Oxide Semiconductor）